

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2023年5月19日(19.05.2023)



(10) 国際公開番号

WO 2023/085314 A1

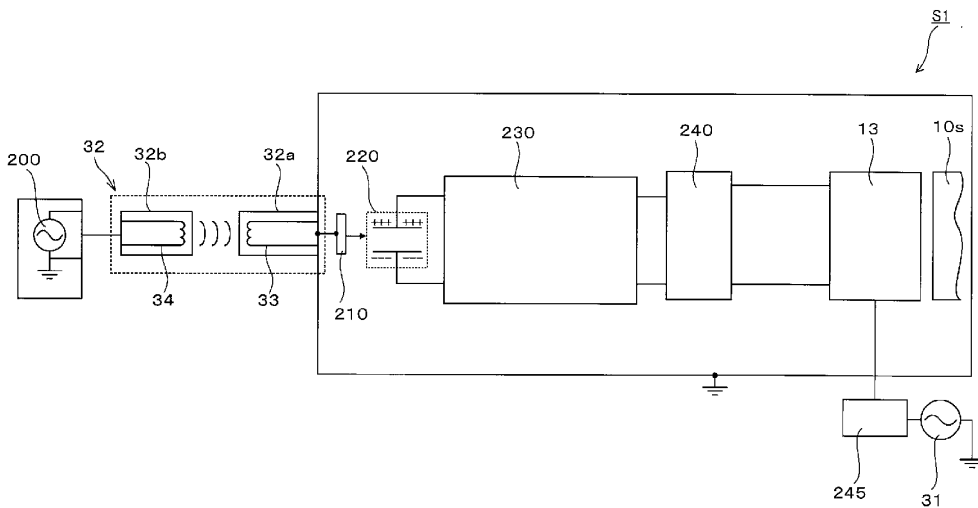
(51) 国際特許分類:
H01L 21/3065 (2006.01) H01L 21/31 (2006.01)
H01L 21/205 (2006.01) H05H 1/46 (2006.01)
(21) 国際出願番号: PCT/JP2022/041701
(22) 国際出願日: 2022年11月9日(09.11.2022)
(25) 国際出願の言語: 日本語
(26) 国際公開の言語: 日本語
(30) 優先権データ:
63/278,721 2021年11月12日(12.11.2021) US
特願 2022-101022 2022年6月23日(23.06.2022) JP
(71) 出願人: 東京エレクトロン株式会社(TOKYO ELECTRON LIMITED) [JP/JP]; 〒1076325 東京都港区赤坂五丁目3番1号 Tokyo (JP).

(72) 発明者: 松本 直樹(MATSUMOTO, Naoki); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ1番 東京エレクトロン宮城株式会社内 Miyagi (JP). 田面木 真也(TAMONOKI, Shinya); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ1番 東京エレクトロン宮城株式会社内 Miyagi (JP). 永海 幸一(NAGAMI, Koichi); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ1番 東京エレクトロン宮城株式会社内 Miyagi (JP). 石川 真矢(ISHIKAWA, Shinya); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ1番 東京エレクトロン宮城株式会社内 Miyagi (JP). 藤原 直樹(FUJIWARA, Naoki); 〒9813629 宮城県黒川郡大和町テクノヒルズ1番 東京エレクトロン宮城株式会社内 Miyagi (JP). 三原 直輝(MIHARA, Naoki); 〒9813629 宮城県黒

(54) Title: SUBSTRATE PROCESSING DEVICE, SUBSTRATE PROCESSING SYSTEM, ELECTRICAL POWER SUPPLY SYSTEM, AND ELECTRICAL POWER SUPPLY METHOD

(54) 発明の名称: 基板処理装置、基板処理システム、電力供給システム及び電力供給方法

[図5]



(57) Abstract: The present invention is a substrate processing device which processes substrates, said device comprising a power receiving unit which includes a power receiving coil along which electrical power is transmitted in a non-contact manner from a power transmission coil located outside the substrate processing device, wherein electrical power is supplied to at least one unit or member that uses electrical power from the power receiving unit.

[続葉有]

WO 2023/085314 A1

川郡大和町テクノヒルズ 1 番 東京エレクトロン宮城株式会社内 Miyagi (JP).

(74) 代理人: 金本 哲男, 外(KANEMOTO, Tetsuo et al.); 〒1620065 東京都新宿区住吉町 1-20 角張ビル 曙国際特許事務所 Tokyo (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

— 国際調査報告 (条約第21条(3))

(57) 要約: 基板を処理する基板処理装置であって、前記基板処理装置の外部に位置する送電用コイルから非接触で電力が伝送される受電用コイルを含む受電部を備え、前記受電部からの電力を利用するユニット又は部材の少なくとも1つに電力を供給するように構成された、基板処理装置。